

塑性加工解析 Seminar 2010のご案内



拝啓 時下ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、今回「塑性加工解析Seminar 2010」を下記の要領で開催いたしますので、ご案内申し上げます。

今やFEMをはじめとして、塑性加工分野への数値解析シミュレーションの適用事例が多く報告されています。しかし複雑形状のモデリング、計算時間、精度の問題、更には熱処理、各種の加工プロセスの問題等があり、更なる研究が望まれています。

そこで、今回は基調講演に横浜国大の酒井譲先生をお招きし、特に複雑形状で粒子数5千～1億の超大規模問題、粉体・高分子複合材料等の加工解析、材料組織と加工熱処理を考慮した塑性解析等、「SPH粒子法による塑性加工解析の最前線」と題して、破壊解析、衝撃解析も含めた最新の塑性加工解析技術に関するご研究をご紹介します。

また、本セミナーでは大規模かつ高速の粒子法解析を可能とする、GPGPUによるSPH粒子法プログラムの大規模化と高速化技術についてもご紹介するとともに、塑性加工分野のSPH粒子法プログラムの商用化についてご説明いたします。更に、塑性加工分野をはじめ、各種分野における先進的解析技術に関する教育・サービスのご紹介、また工業用内視鏡を使用したデモンストレーションを行います。

本セミナーは、新しいものづくりを目指す現場の設計・解析技術者をはじめ、研究者の方々にとって有意義なものになることと確信しております。お忙しい時期とは存じますが、この機会にぜひご参加下さいませようご案内申し上げます。 敬具



ご出席された方には下記のSPH粒子法プログラムCD(Windows XP/バイナリ形式)が提供されます。

2次元解析：平面応力、ひずみ 解析種別：弾性、弾塑性、粘弾性、大変形、クラック進展
対象材料：金属、粘弾性体 プレポスト：2次元処理用 粒子数制限：10万

【開催日時】 2010年9月17日(金) 13:30~17:30 (受付13:00~)

【場所】 タイム24ビル 1階 HALL2 (東京都江東区青海2-4-32)

【参加費】 無料

【定員】 50名

【セミナープログラム】

- 13:30~ : ご挨拶.....エイシーティ株式会社 代表取締役 山縣 延樹
- 13:45~ : 基調講演 「SPH粒子法による塑性加工解析の最前線」.....横浜国立大学 教授 酒井 譲
- 15:15~ : 休憩
- 15:30~ : SPH粒子法のGPGPUによる並列処理プログラム技術.....HPCシステムズ株式会社 取締役会長 英 憲悦
- 16:30~ : 先進的解析技術に関する教育・サービス.....アトリCAE株式会社 代表取締役 有吉 智彦
- 17:00~ : 塑性加工分野における工業用内視鏡の適用.....エイシーティ株式会社 桂 健助
- 17:20~ : まとめと閉会ご挨拶.....エイシーティ株式会社 代表取締役 山縣 延樹



セミナー会場イメージ



タイム24ビル 1階 HALL2

以下をご記入いただくか、名刺を添えてコピーの上、FAXにてお申込みください
(参加申込みは恐れ入りますが、9月14日(火)までにお送りください)。

貴社名 : _____
 ご所属 : _____
 ご氏名 : _____
 ご住所 : 〒 _____

 TEL : _____
 FAX : _____
 E-mail : _____

- ・セミナーの参加について口で✓とご記入ください
- セミナーに参加する
- セミナーには参加できないが、講演テキストの送付を希望する
- ・Webからセミナー参加をお申込みされる方は下記よりお願いします。
- URL : http://www.hpc.co.jp/inquiry_portal.html

■セミナーのお問合せ先

HPCシステムズ株式会社 セミナー係 (〒135-8073 東京都江東区青海2-4-32 タイム24ビル 10F北)
 TEL:03-3599-3652 FAX : 03-3599-3655 E-mail : hpcs_sales@hpc.co.jp

■セミナー会場

タイム24ビル1階 HALL2 (〒135-8073 東京都江東区青海2-4-32)



タイム24ビル 1階 HALL2

■アクセス

交通手段

- ・東京臨海高速鉄道で「東京テレポート」からタイム24ビル専用無料循環バスで3分
- ・東京臨海新交通（ゆりかもめ）で新橋駅より約17分「テレコムセンター」下車、徒歩3分

道順

テレコムセンター改札口を出て、進行方向突き当たり（タイム24の案内板あり）を右に曲り、地上に降ります。そのまま進みますと右手にタイム24ビルが見えます。



【免責事項】

・セミナーの受付は定員になり次第終了いたします。参加を希望される方はお早目にお申込みくださいますようお願いいたします。